

Page 1 of 7

新闻稿

实时发布

香港科技园公司与微电子企业杰平方半导体签署合作备忘录 共同推动香港微电子产业发展

杰平方半导体宣布启动香港首间碳化硅 (SiC) 先进垂直整合晶圆厂项目

计划落户科学园设立研发中心 实行自主研发及生产第三代半导体芯片

- 科技园公司与杰平方半导体的合作是由创新科技及工业局和引进重点企业办公室共同推动，以持续完善香港创科生态圈以及推动「新型工业化」。
- 科技园公司与杰平方半导体签署合作备忘录，共同推动香港微电子产业发展，有助杰平方半导体在香港建设第三代半导体碳化硅 8 寸先进垂直整合晶圆厂项目正式启动，共同推进香港微电子生态圈及第三代半导体芯片产业的发展。
- 杰平方半导体预计总投资额约港币 69 亿元，按规划通线、扩产，于 2028 年达到年产量 24 万片碳化硅晶圆，带动年产值超过港币 110 亿元，并创造超过 700 个就业岗位。

(香港·2023 年 10 月 13 日) 由创新科技及工业局和引进重点企业办公室共同推动，香港科技园公司 (科技园公司) 与微电子企业杰平方半导体 (上海) 有限公司 (杰平方半导体) 签署合作备忘录，在科学园设立以第三代半导体为主的全球研发中心，并投资开设香港首间碳化硅 (SiC) 8 寸先进垂直整合晶圆厂，共同推进香港微电子生态圈及第三代半导体芯片产业的发展。

香港特区政府创新科技及工业局去年公布的《香港创科发展蓝图》中，明确指出应加强支持具策略性的先进制造产业发展，譬如半导体芯片，促进香港「新型工业化」的发展。作为全球最大的半导体进出口市场之一，香港更是位处大湾区核心位置，拥有具大潜力能成为全球半导体供应链和价值链的关键枢纽。

创新科技及工业局局长孙东教授表示：「今次科技园公司和杰平方半导体的合作项目，是香港历史上设立的第一家具规模的半导体晶圆厂，反映本届特区政府正在将『新型工业化』、聚焦半导体芯片前沿领域的发展从口号、从规划转化为实际行动。杰平方半导体亦计划积极培训本地人才，提升本港在科技方面的人力资源素质和竞争力。此外，项目还将带动相关产业的发展，包括半导体设备制造商、材料供货商、测试服务提供商等，从而提升香港在全球半导体产业价值链中的地位。」

Page 2 of 7

是次科技园公司与杰平方半导体的合作是由创新科技及工业局和引进重点企业办公室共同推动，以持续完善香港创科生态圈以及推动「新型工业化」。在创新科技及工业局局长孙东教授、引进重点企业办公室主任容伟雄先生、创新科技及工业局副局长张曼莉女士、香港科技园公司主席查毅超博士及杰平方半导体（上海）有限公司董事长俎永熙博士见证下，香港科技园公司行政总裁黄克强先生与杰平方半导体（上海）有限公司联合总经理朱东园先生签署合作备忘录。

香港科技园公司主席查毅超博士表示：「香港的微电子产业发展潜力庞大，是次杰平方半导体计划落户科学园，推动香港生产自主研发的第三代半导体芯片，将先进的电动车芯片设计、制造流程和半导体产品开发的核心技术与专业知识带入香港，为本港微电子产业发展的重要里程碑。作为香港的旗舰创科平台之一，我们提供高水平的基建和配套、庞大的合作伙伴网络，将继续推动本港微电子的研发实力，巩固香港作为国际创新科技中心的地位。」

杰平方半导体（上海）有限公司董事长俎永熙博士表示：「非常感谢香港创新科技及工业局、香港科技园，对本项目的高度重视和支持！签署合作备忘录标志着我们正式启动第三代半导体『碳化硅 8 寸先进垂直整合晶圆厂』的项目计划。该项目的总投资额预约港币 69 亿元，按规划通线、扩产，于 2028 年达到年产量 24 万片碳化硅晶圆，带动年产值超过港币 110 亿元，并创造超过 700 个本地及吸引国际专业人士来港的就业职位。包括芯片及微电子产品设计、微电子模块化及生产流程发展等，以进一步推动香港多元经济发展。项目将在香港迎来蓬勃发展，助力早日完成新能源车供应链国产化的宏图伟业，并带动香港地区半导体产业的长期发展与繁荣！」

杰平方是聚焦车载芯片研发的芯片设计企业，杰平方致力于满足中国汽车产业对国产自主车载芯片的旺盛需求，主要面向电能转换、通信等领域，提供高性能碳化硅（SiC）芯片、车载信号链芯片及车载仿真片等前沿产品。其卓越的硅基功率芯片技术更可应用到电动车等相关应用，亦可优化相关的基础设施的发展，例如充电站、智慧电网和能源储存等。

科技园公司一直致力推动香港的「新型工业化」进程，打造世界领先的微电子生态圈。现时科技园已建设了完善的微电子硬件设施，包括传感器封装集成实验室（Sensor Lab）、异构系统整合实验室（HI Lab）及硬件实验室（Hardware Lab），这些设施能支持芯片相关的设备和系统以至产品的设计、原型制作及试点生产的完整流程。位于元朗创新园的微电子中心预计于

Page 3 of 7

2024 年启用，将配合科技园公司多项基础建设，加速微电子研发及中试，为上下游企业及产业链创造机遇。

科技园公司的微电子生态圈发展蓬勃，目前，共有超过 200 间从事微电子产业相关的公司，杰平方半导体落户香港，将产生更大的协同效应及知识交流。现时本港有五所大学的排名位列全球首 100 名，当中更有逾 100 名大学研究人员从事微电子领域研究，能为行业提供相关的专业人才，推动第三代半导体的研发。香港特区政府在今年的财政预算案更宣布打算设立一所微电子研发院，强化与大学、研发中心和业界的合作，加快「从一到 N」的科研成果转化，促进产业发展。



图一：在创新科技及工业局局长孙东教授（后排中间）、引进重点企业办公室主任容伟雄先生（后排左一）、创新科技及工业局副局长张曼莉女士（后排右一）、香港科技园公司主席查毅超博士（后排左二）、杰平方半导体（上海）有限公司董事长俎永熙博士（后排右二）见证下，香港科技园公司行政总裁黄克强先生（前排左）与杰平方半导体(上海)有限公司联合总经理朱东园先生（前排右）共同签署合作备忘录。



图二：一众嘉宾见证香港科技园公司与内地微电子企业杰平方半导体（上海）有限公司签署合作备忘录，共同推动香港微电子生态圈及第三代半导体芯片产业的发展，包括：

- 香港特别行政区创新科技及工业局局长孙东教授（左十一）
- 香港特别行政区引进重点企业办公室主任容伟雄先生（左九）
- 香港特别行政区创新科技及工业局副局长张曼莉女士（右七）
- 香港科技园公司主席查毅超博士（左十）
- 杰平方半导体（上海）有限公司董事长俎永熙博士（右九）
- 香港科技园公司行政总裁黄克强先生（左八）
- 宁德时代新能源科技股份有限公司副董事长李平先生（右八）
- 香港高通资本集团董事长马志刚先生（右六）
- 中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司董事总经理王蓓蓓女士（右五）
- 北京屹唐长厚创业投资基金管理有限公司基金合伙人谢宏伟先生（右一）
- 小米集团产业投资部投资总监张凌捷（右二）
- 海南柏睿投资有限公司基金合伙人王利民先生（左四）
- 杰平方半导体（上海）有限公司联合总经理司徒道海先生（左五）
- 杰平方半导体（上海）有限公司联合总经理朱东园先生（右四）
- 杰平方半导体（上海）有限公司财务长吴曼宁女士（右三）



Page 5 of 7



图三：创新科技及工业局局长孙东教授致辞时表示：「今次科技园公司和杰平方半导体的合作项目，是香港历史上设立的第一家具规模的半导体晶圆厂，反映本届特区政府正在将『新型工业化』、聚焦半导体芯片前沿领域的发展从口号、从规划转化为实际行动。杰平方半导体亦计划积极培训本地人才，提升本港在科技方面的人力资源素质和竞争力。」



图四：香港科技园公司主席查毅超博士表示：「是次杰平方半导体计划落户科学园，推动香港生产自主研发的第三代半导体芯片，将先进的电动车芯片设计、制造流程和半导体产品开发的核心理技术与专业知识带入香港，为本港微电子产业发展的重要里程碑。」

Page 6 of 7



图五：杰平方半导体（上海）有限公司董事长俎永熙博士表示：「非常感谢香港创新科技及工业局、香港科技园，对本项目的高度重视和支持！签署合作备忘录标志着我们正式启动第三代半导体『碳化硅 8 寸先进垂直整合晶圆厂』的项目计划。」

###

关于香港科技园公司

香港科技园公司（科技园公司）成立逾 20 年，致力将香港发展成为国际创新科技中心，积极让本地及全球创新者迈向成功，帮助他们在未来获得更大成就。科技园公司在香港建立了蓬勃的创科生态圈，过去共支持超过 10 间独角兽企业，亦汇聚超过 13,000 名研究人才，以及超过 1,400 间从事生物医药技术、人工智能及机械人技术、金融科技及智慧城市发展的科技公司。

科技园公司于 2001 年成立，一直大力吸纳及孕育创科人才、加速创科成果商品化，为创业家的创科路上提供全方位支持。我们建立的创科生态圈持续成长，足迹遍及全港，包括沙田的香港科学园、九龙塘的创新中心，以及位于大埔、将军澳及元朗的创新园。三个创新园结合创新元素，朝着香港新型工业化发展方向，重点带动先进制造业、微电子业及生物科技等行业，重新定位新世代工业。

科技园公司透过提供基础设施、支持服务、专业知识及合作伙伴网络，致力令创新科技成为香港的新经济动力，巩固香港国际创新科技中心的地位，同时借助位处大湾区核心的优势，成为引领创科发展的重要引擎。

Page 7 of 7

更多有关香港科技园公司的详情，请浏览 www.hkstp.org。

关于杰平方半导体（上海）有限公司

杰平方半导体（上海）有限公司（以下简称“杰平方”）是聚焦车载芯片研发的芯片设计企业，杰平方现有芯片设计总部位于上海。杰平方致力于满足中国汽车产业对国产自主车载芯片的旺盛需求，主要面向电能转换、通信等领域，提供高性能碳化硅（SiC）芯片、车载信号链芯片及车载仿真片等前沿产品。杰平方积极拓展车载功率芯片、车载信号链、车载仿真芯片等前沿产品，并按照主机厂商需求进行定制开发，包含高边驱动（HSD）、低边驱动（LSD）、半桥驱动（HBD）、同步降压转换器（DCDC）。

杰平方有效整合国际技术经验和本土资源，深刻把握本土客户定制化需求，与国内外数家汽车产业链知名企业深入合作，提供高质量交付方案。核心团队芯片设计及半导体工艺造诣精深，产能保障、车规级产品认证、供应链管理能力强，具备研-产-用一体化的系统化优势。秉持“诚信、创新、以人为本”的精神，杰平方凭借自身优势设计能力、对产业的独到理解，致力实现中国本土车载芯片的自主可控，并且在第三代半导体碳化硅器件生产领域成为世界级的领先企业（IDM 模式）。

杰平方已获得多家顶尖投资机构、著名汽车零部件生产企业、通讯技术头部企业的投资与支持。

更多有关杰平方半导体（上海）有限公司的详情，请浏览 www.j2semi.com。

传媒查询，请联络：

香港科技园公司

温安怡

电话：+852 2629 2329

电邮：angela.wan@hkstp.org

爱德曼国际公关公司

黄嘉琪

电话：+852 3756 8623 / 6986 5822

电邮：June.Wong@edelman.com /
Edelmanhkstppr@edelman.com

杰平方半导体（上海）有限公司

邱晨亮

电话：+8621 3875 5958

电邮：J2adhr@j2semi.com